



DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
(art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016)

STRUTTURA: Sezione di Ferrara

DETERMINA n. 324 del 14 giugno 2018

OGGETTO: Planarizzazione silicio

RUP: Sig. Stefano Squerzanti

IMPORTO PRESUNTO DELL' ACQUISTO: € 8.400,00 (esclusa IVA)

ESPERIMENTO: UA9

CAPITOLO: U1030102008 Strumenti tecnico-specialistici.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

- Indagine di mercato come da relazione allegata..

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE:

- Richiesta di preventivi a 3 operatori economici fuori MEPA

Data di pubblicazione sul sito www.ac.infn.it - Sezione
"Bandi ed esiti di gara": 19/06/2018

IL DIRETTORE
Prof. Raffaele Tripiccone



Ferrara 14/06/2018

Caro direttore,

l'esperimento UA9 ha la necessità di diminuire l'angolo tra la superficie fisica di tre wafers in silicio ed i loro piani atomici da un valore iniziale 120 microradianti a meno di 10 microradianti, allo stesso tempo è necessario che la superficie del wafer venga modellata in modo da avere una planarità non inferiore a 50 nm. La superficie del wafer deve altresì risultare esente da danno reticolare indotto dal processo di lavorazione. I tre wafers oggetto della lavorazione hanno diametro di 100 mm e spessore di 2 mm.

L'unico modo scientificamente riconosciuto per raggiungere tale risultato, è tramite l'uso di tecniche di lucidatura deterministiche; tra queste spicca l'uso di fasci di argon di bassa energia (1 KeV) diretti sulla superficie di interesse, in modo da modellarla. Tale tecnica permette infatti di soddisfare tutti i requisiti sopra descritti.

Al fine di realizzare quanto di interesse, si sono contattate tre aziende (Medialario, Ametek ed NTG), di questa solo l'azienda NTG (Germania) si è resa disponibile. Il costo proposto, di euro 8423.43+IVA è giudicato congruo rispetto alla lavorazione da eseguire.

Il proponente

Andrea Mazzolini

ILRUP

